



半导体产品与半导体设备行业信息点评：资本开支维持高位 看好国内设备龙头公司持续成长



投资要点:2021 年半导体设备市场规模创历年新高;国内晶圆、封装测试环节扩产仍维持高位水平;看好设备厂商国产渗透率的提升。

2021 年全球半导体设备市场规模创历年新高,达 1030 亿美金,同比增 44.7%。根据 SEMI 的《Year-End Total Semiconductor Equipment Forecast—OEM Perspective》披露数据,2021 年全球半导体设备的市场规模将有望达 1030 亿美金,创历史新高水平,较 2020 年的 710 亿美金同比增 44.7%;此外,预计 2022 年将持续增加至 1140 亿美金。其中晶圆处理设备市场规模 2021 年、2022E、2023E 将分别为 880.1 亿美金、988.8 亿美金和 983.9 亿美金;封装设备市场规模 2021 年、2022E、2023E 将分别为 69.9 亿美金、72.9 亿美金和 70.4 亿美金;测试设备市场规模 2021 年、2022E、2023E 将分别为 77.9 亿美金、81.7 亿美金和 79.9 亿美金。

晶圆制造端,看好下游客户扩产不断。代工领域的扩产计划包括但不限于无锡华虹集成电路一期扩产项目计划总投资 52 亿元,将形成一条工艺等级 90-65/55nm、月产能 6.5 万片的 12 英寸特色工艺集成电路芯片生产线;根据芯思想公众号披露,晶合集成 N2 厂已经投入生产,N3 厂规划提上日程,计划建置 4 万片产线等。

封装测试端,我们认为受 2021 年资本开支高点影响,2022E 资本开支会有一定程度放缓,但同比下降幅度可控,龙头公司、新晋公司仍维持较高水位的资本开支。1、龙头公司定增扩产。根据华天科技《非公开发行股票发行

情况报告书暨上市公告书》(2021.11.05)披露,公司成功完成非公开发行股票募集资金净额为 50.48 亿元,发行价格为 10.98 元/股。发行募集配套项目包括集成电路多芯片封装扩大规模项目、高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目、TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目、存储及射频类集成电路封测产业化项目、补充流动资金等。2、新晋公司积极发展。根据爱集微报道,江苏芯德科技成立于 2020 年 9 月,主要从事凸块、WB 封装、倒装封装、系统级封装、异质性封装等高端封测技术以及测试一站式服务。目前公司已成功完成 A 轮和 A 轮+两轮融资,其中 A 轮+融资有金浦新潮、君海创芯领投,小米长江产业基金、OPPO、恒信华业等投资机构跟投。

投资建议。我们认为集成电路产业为国家战略性新兴产业,关系到信息安全问题,战略地位极其重要;预计 2022E、2023E 我国晶圆代工、封装测试端仍将维持较高水位的资本开支,产能扩充主要满足国内芯片设计公司的代工、封装测试需求。受益于下游资本开支持续,我们认为国内半导体设备公司的核心成长逻辑仍然是伴随下游产线的不断建设带来国产设备渗透率的不断提升,建议关注半导体设备环节相关优质公司的投资机会,包括华峰测控、北方华创、盛美上海、中微公司、长川科技等。

风险提示:宏观经济波动的风险、下游需求不及预期、资本开支不及预期等。

关键词: 芯片

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_36338

